

会社案内



株式会社 熊本マランツ

会社概要

社名

株式会社 熊本マランツ

所在地

熊本県宇土市花園町西原2024

設立

1972年(昭和47年) 10月5日

資本金

5,000万円

役員

代表取締役	深津	悦夫
取締役	内川	智
取締役	西澤	英樹(マランツエレクトロニクス(株)代表取締役会長)
取締役	元木	満(マランツエレクトロニクス(株)代表取締役社長)
監査役	齋藤	仁宏(マランツエレクトロニクス(株)管理部長)

従業員

92名(2025/5/16現在)

土地建物

土地 10,720m² 建物 5,080m²

事業内容

電気・電子機器組立(SMT実装～DIP～機器組立)
装置組立(各種産業機器・製造装置組立)



マランツエレクトロニクス グループ

エレクトロニクス マニュファクチャリング サービス(EMS)

- MEK：基板設計～部品調達[集中購買]
- グループ工場：実装～ASSY・組立て

岩手県宮古市
株式会社 宮古マランツ

電気・電子機器組立
(SMT実装～DIP～機器組立)

神奈川県大和市
株式会社 エムイーエス

電気・電子機器組立
(SMT実装～DIP～機器組立)

岩手県一関市
株式会社 千厩マランツ

電気・電子機器組立
(SMT実装～DIP～機器組立)

熊本県宇土市
株式会社 熊本マランツ

神奈川県横浜市
本社

マランツエレクトロニクス 株式会社

【主要製品/サービス】
基板外観検査装置の設計・製造・販売



沿革

1972年10月	日本マランツ(株)の子会社として設立,音響機器の生産開始
1989年01月	音響から通信機へ生産アイテム変更
1989年03月	SMT実装機導入、チップ部品の実装開始
1996年02月	ISO9001認証取得 (TÜV)
1996年10月	半導体製造装置組立開始
2002年	日本マランツ(株)より分社化したマランツエレクトロニクス(株)の子会社となる
2004年04月	ISO14001認証取得 (TÜV)
2010年12月	大型産業機器基板及びLED照明の生産開始
2017年01月	自動梱包機械の生産開始
2025年05月	X:640*Y:610 超大型基板SMT実装ライン増設

企業理念と基本方針

企業理念

私たちは、日本で電子機器の生産を行う顧客に、誠意と技術をもって応え、一人一人の成長と、会社の発展を目指す。

基本方針

品質、サービス、生産、物流、納期及びお客様対応等全ての面でお客様に喜んで頂けるように努める。

高い生産技術力を身に付け、我社でしかできないものづくりをする。

高付加価値の創出。

常に人の為に仕事をする。

いい仕事をして、仕事が仕事を集める。

仕事と人が、共に成長する職場にする。

「継続は力なり」後戻りのない常に改善する会社にする。

常に自分に厳しく、向上心を持つ。

品質方針

顧客要求を第一に考え、顧客要求を満足する製品品質を確保するために、社員一人一人が自主的に必要な改善を行い、顧客満足度の向上を図る。

主 要 取 引 先

- オムロン阿蘇 株式会社
- 旭化成テクノシステム 株式会社
- 三菱電機エンジニアリング 株式会社
- 東洋電装 株式会社
- 株式会社 京製メック
- エステイケイテクノロジー 株式会社
- アドバンテック 株式会社
- 三和ニューテック 株式会社
- 株式会社 羽野製作所
- 櫻井精技 株式会社
- 株式会社 ホックス
- 熊本テクノ 株式会社
- テクノデザイン 株式会社
- 明光電子 株式会社
- 千代田電子機器 株式会社
- マランツエレクトロニクス 株式会社

1. 基板実装事業(EMS製造部)

受託範囲：部品調達～SMT実装～後加工迄の一貫生産

主力アイテム：産業機器・パワコン・医療機器・自動車・LED照明・電車等

SMT実装：生産

- プリント基板の高精度・高密度実装が可能な製造設備を有しており、試作・少量多品種案件から量産品まで幅広く対応致します
- 産業機器／バーインボード等の大型サイズの基板実装を得意としております (X:640*Y:610*t:8.0迄)
- 社内認定者による作業で高品質を確保
(マシンオペレーター、目視検査、はんだ付け)
 - 機械実装可能スペック、部品サイズ
 - QFP(0.4mmピッチ)、BGA(0.5mmピッチ)
 - チップ実装(0402)、ボンド実装(1608)



▲0402対応SMT高速実装機

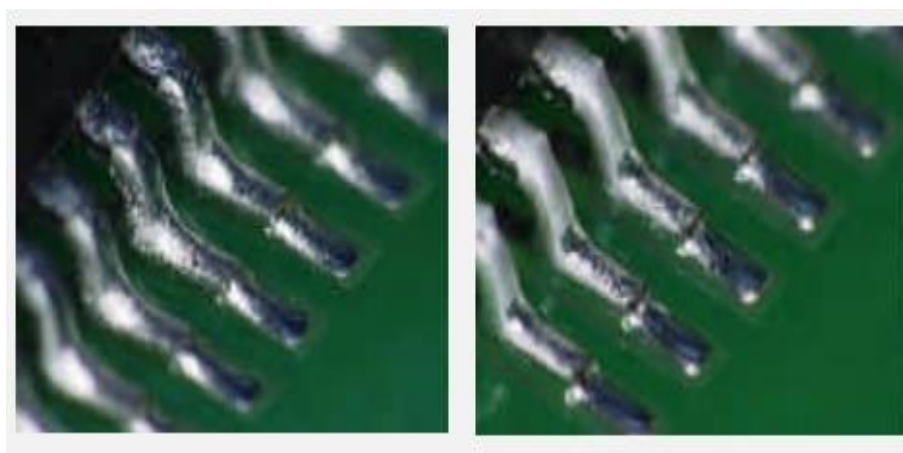
SMT実装：生産

N2 リフロー炉：SMT 実装ライン全てに対応

- 窒素雰囲気リフローによる高耐久性のはんだ付けが可能です
- 部品電極や基板ランドなどの酸化を抑制でき、高信頼性のはんだ付けが可能です
- はんだの濡れ性が向上し、フィレット形成が改善されます



▲千住金属工業 SNR-1050GT



▲N2リフロー

▲大気リフロー

CO2 レーザーマーカ（基板両面印字）

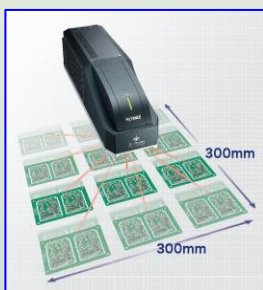
- 2次元コードを生基板に直接印字することで、製造工程情報及び部品ロットのトレースが可能です
- 2次元コード入りの基板は、各工程で製造情報(生産履歴、修理履歴、作業者情報等)が記録され、トレーサビリティ管理されます
- コードに紐づいた検査画像が残り、必要に応じて検索が可能です



印字：バーコード・QRコード・英数文字・ロゴ等



生産プロセスと部品LOTのトレースシステム



QRコードを基板に書き込んで
SMTラインに投入

バーコード

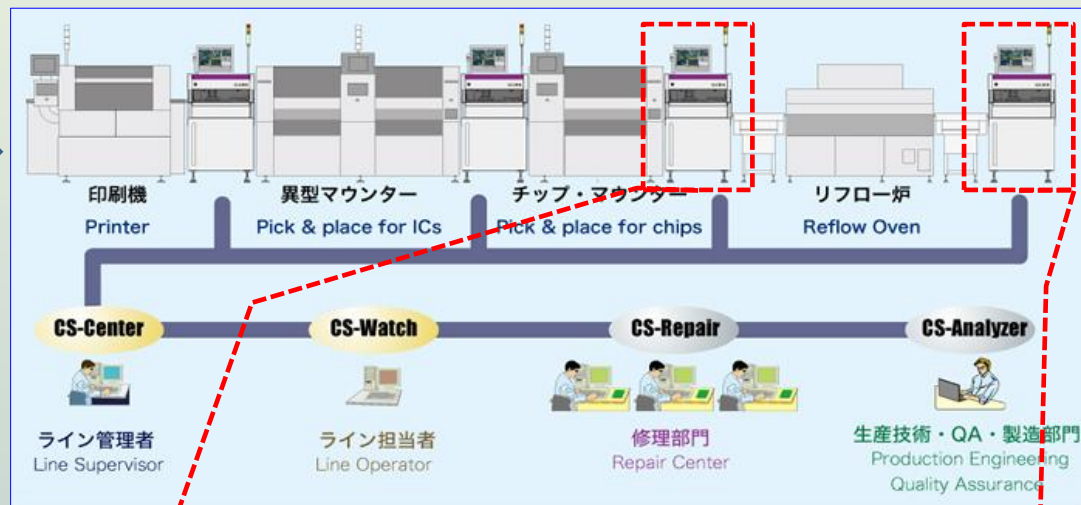


データ量の圧縮

西暦+日付+時間+
ロット+シリアルなど

従来は難しかった
重複の無い採番も可能

二次元コード



- ◆インライン・リフロー後履歴照合可能
- ◆検査データ画像保管



SMT実装：品質

- リフロー前のインラインAOIによる迅速なフィードバックが可能です
- AOIキャッチシステムによる良品判定画像を含めた全画像データの長期保存管理に対応(シリアル・QRコード情報も保存可能)
- 基板1シート毎のレーザーマーキングによる基板トレース管理や部品補充管理システムによる部品トレース管理が可能です
- 社内不良情報をデータベース化したシステムを構築しております



▲U22X-FMA650 (検査範囲 X:650 * Y:550)
マランツエレクトロニクス製 AOI

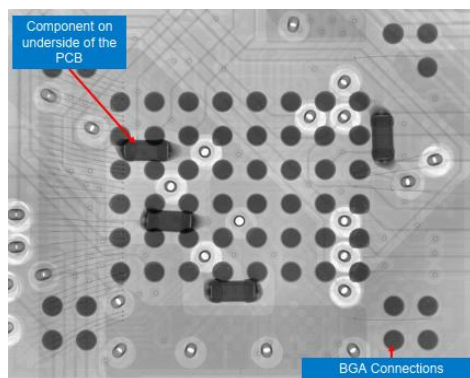


▲部品補充管理システム

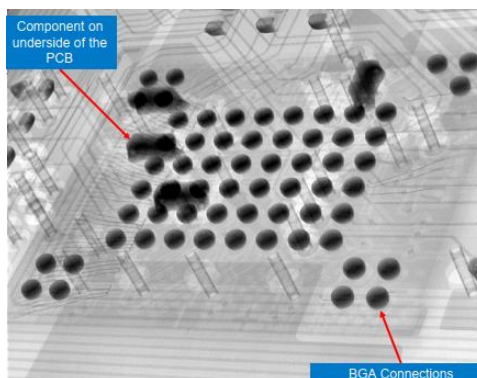
マイクロフォーカス X線検査装置 導入

- X線画像検査がXL型基板まで対応可能 (最大検査範囲：510 × 444 mm)
- X線検出器を最大70°傾動、サンプルを中心に360°方向からモニター観察、画像取得・動画撮影が可能です
- 検査結果の解析や不具合時のトレーサビリティ管理が可能です

高倍率、高解像度の画像や動画を
安定的に取得可能



▲ 真上から撮影

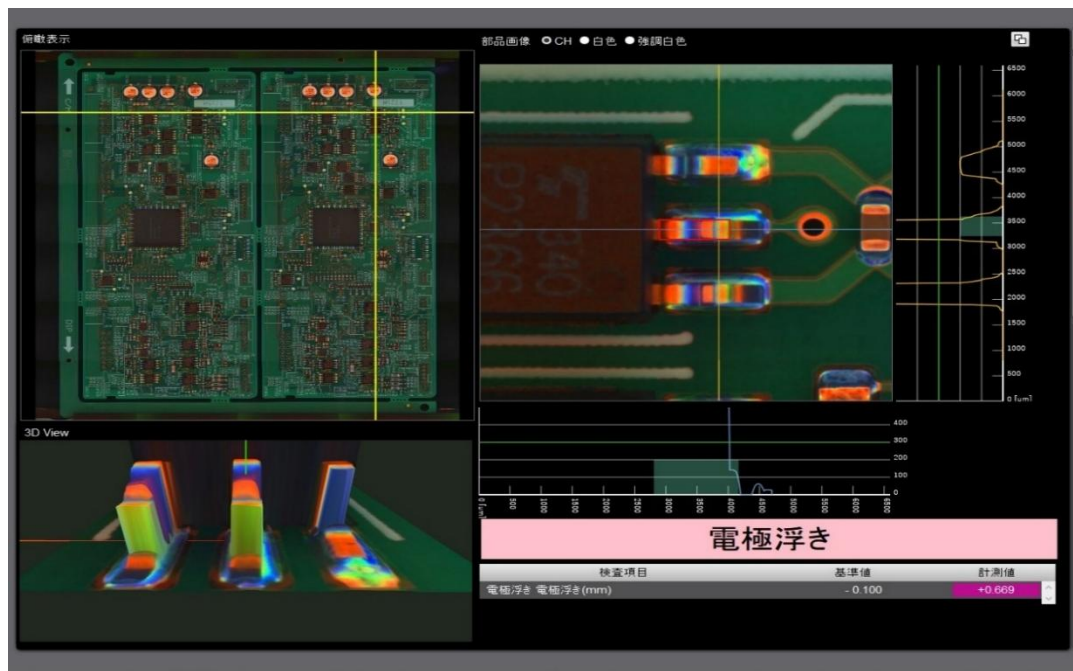


▲ 斜め方向から撮影



3D-AOI 導入

- 検査精度向上により虚報(見過ぎ)が少なく、判定ミスリスクが改善
- 不良を捉えた際、「不良名」が画面に表示され判定しやすい
- 検査タクトが早く、検査処理能力が向上



VT-S1080

後加工(フローはんだ～組立)

- 鉛フリー、共晶の自動はんだ付け装置(フロー槽 + 自動ポイントフロー槽)を保有しており、各基板仕様に応じたはんだ付けに対応しております
- 大型基板(X:610*Y:460*t:2.0)の鉛フリーはんだ付けが可能です
- 基板洗浄(一部外注含む)、防湿剤塗布(自動塗布・刷毛塗)に対応
- ICTのボードやフローパレット等、各種治具が製作可能です
- 各種 機器組立迄の一貫生産に対応しております



▲ L型基板対応 鉛フリー フロー槽



▲産業機器用 大型基板

後加工(防湿剤自動塗布)

自動塗布機によるワンランク上の高品質コーティング

- 専用機を使用した基板防湿処理(自動塗布)が可能です
- 溶剤の塗布ムラが無く、均一にコーティングが可能です
- 塗布後の個体差が少ない高品質を実現します

【取り扱い溶剤】

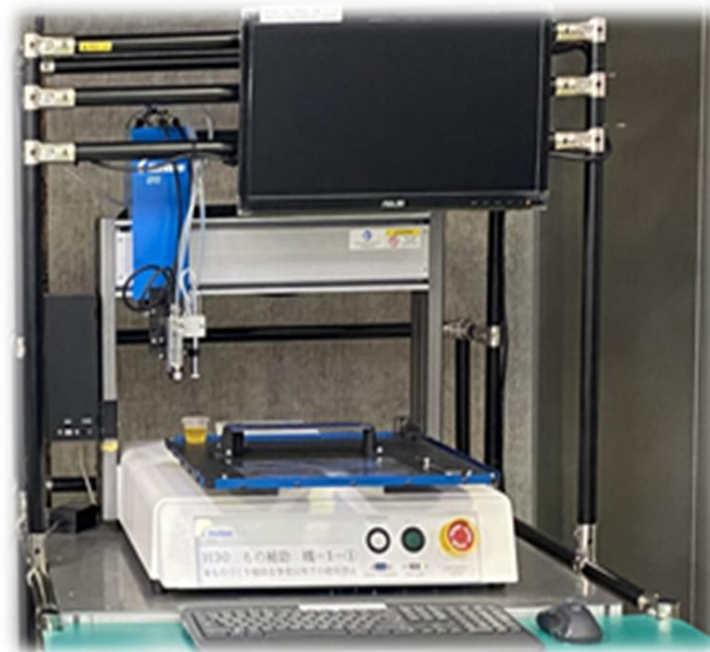
-自動機-

ヒューミシール 1A27NSLU

ヒューミシール 1B51NSLU

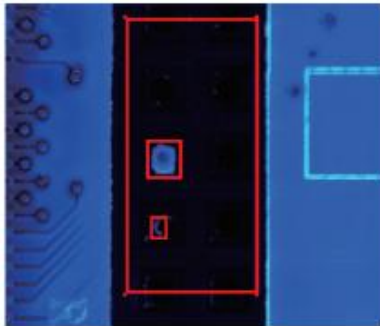
-手塗り-

エレップコート LSS-520

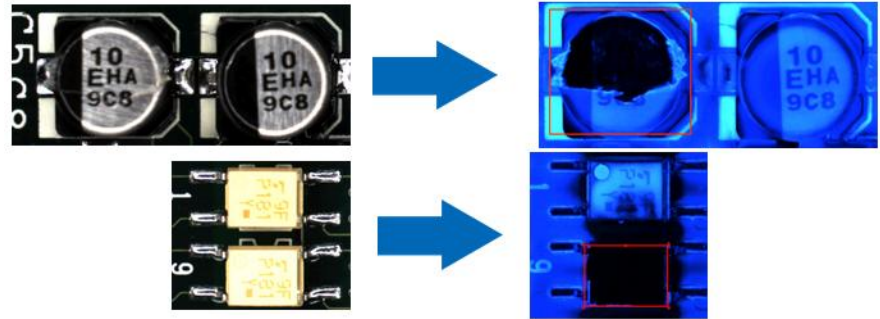


防湿剤塗布検査(UV-AOI)

- 基板防湿処理の塗布漏れや塗布禁止箇所の誤塗布を画像にて検出が可能です ※UV添加防湿剤の塗布



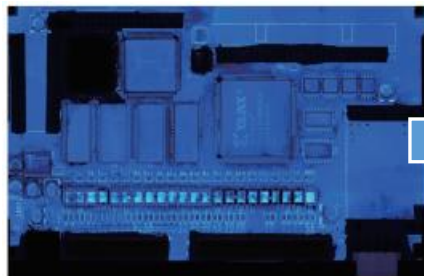
▲禁止エリアの溶剤飛散検出



▲UVライトによる塗布漏れの検出

- 基板実装後の部品角度ズレ、搭載位置(極性・誤実装・文字・キズ・汚れ)の検出が可能です

塗布エリアの塗布有無箇所の識別が容易に目視可能



↑ UV照明のみ



↑ 白色照明 + UV照明



マランツエレクトロニクス製 UV-AOI

V22XUV-520

X線チップカウンター

従来の手動リールカウンタの問題点をX線カウンタで解決

- チップ部品のカウント作業時間が大幅に短縮します
- 正確かつ短時間で棚卸しが可能です
- 作業者のスキルレス化(誰でも操作可能)



幅: 900mm
奥行: 1640mm
高さ: 1900mm

現行モデル: HAWKEYE 2000 (KnK製)

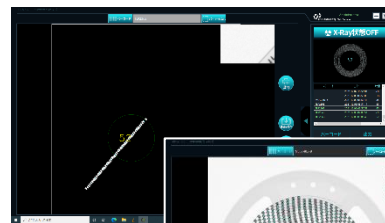


▲従来は巻取りでカウントを行い、
カウント後の巻き戻しが必要であった



▲リールを置きスタートスイッチを押すだけの簡単操作

時従来時間の約1/4以下 ※自社調べ



←スティック品も
袋のまま投入OK



← 部品のバーコードラベルを
付属のハンディスキャナで
読み込み



ラベルプリンタ
付属

↑ 型式・カウント情報は
ラベル印刷が可能

静電気を発生させない環境づくり

- ESD コーディネータ資格取得者による社内ESD環境の構築
社内静電気管理基準を設け、帳票類で見える化し管理
- 作業区画には導電性マット敷き、
静電気対策を施した自社製の台車・作業台を完備
- SMT実装フロアは、ミスト噴霧器による湿度コントロールで
静電気発生を抑制
- はんだ印刷機前にイオナイザを配置



スプレーイングシステム
(噴霧器)



イオナイザによる除電



ESD対策台車

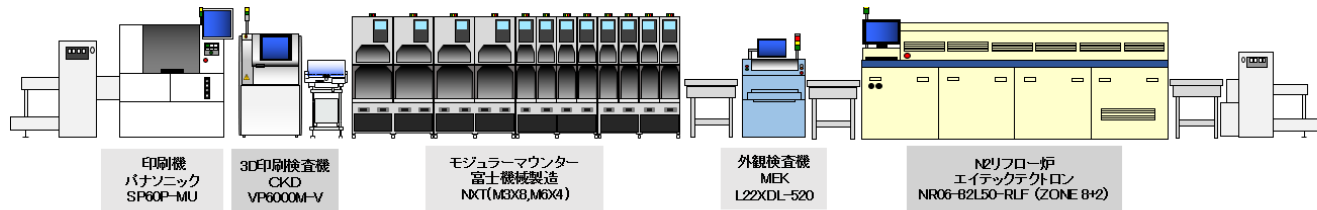


ESD対策作業台

SMTライン設備構成

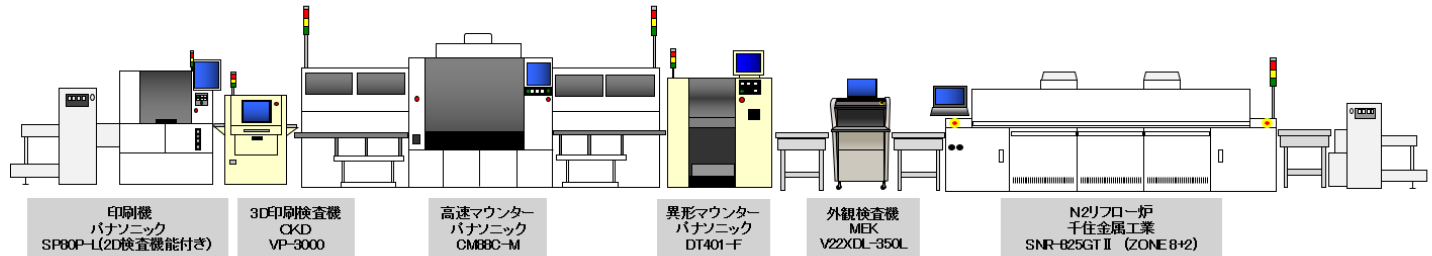
1号機

対応基板サイズ
Min 100×80~Max 330×250
対応基板厚 T0.6~3.0
対応部品 0603~



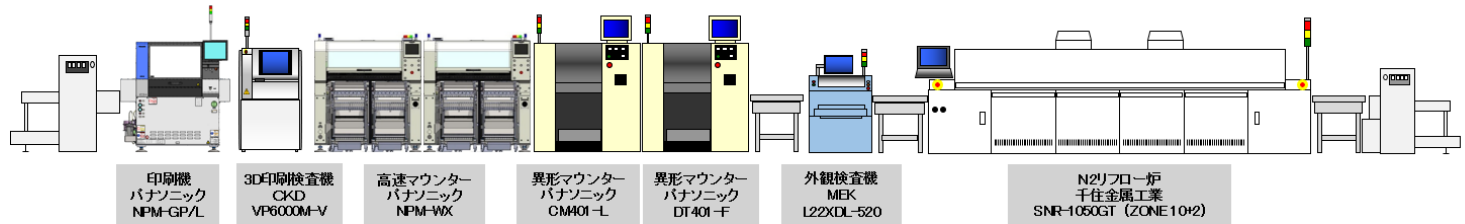
2号機

対応基板サイズ
Min 80×50~Max 330×250
対応基板厚 T0.6~3.0
対応部品 1005~



3号機

対応基板サイズ
Min 80×50~Max 330×250
対応基板厚 T0.6~3.0
対応部品 0603~



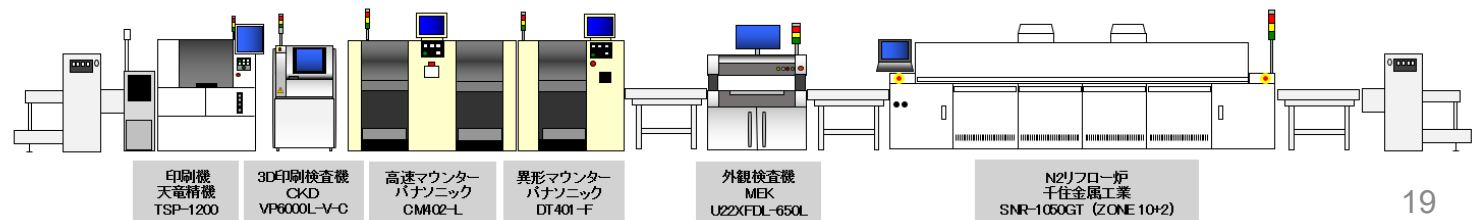
4号機

対応基板サイズ
Min 85×80~Max 640×610
対応基板厚 T0.6~8.0
対応部品 0402~
対応基板重量 10kg



5号機

対応基板サイズ
Min 85×80~Max 640×460
対応基板厚 T0.6~3.0
対応部品 0603~

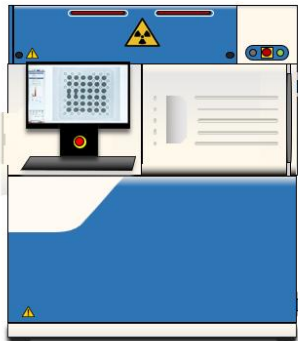


検査機・リペア機・フロー設備

X線検査装置

対応基板サイズ
Max 460×640

ノートン DAGE
Quadra 3



フィクスチャレステスター

対応基板サイズ
Min 50×50～
Max 460×640
基板厚 0.6～3.0t

タカヤ
APT-7400CJ



アウトライン 3D画像検査装置

対応基板サイズ
Max 815×680mm
基板厚 0.4～8.0t
対応基板重量 12.0kg

OMRON
VT-S1080L



アウトライン検査装置 (2台)

対応基板サイズ
Min 50×50～Max 550×650
対応基板厚 0.3～4.0t

外観検査機
MEK
U22XFMA-650



アウトライン検査装置(UV対応)

対応基板サイズ
Min 50×50～Max 550×650
対応基板厚 0.3～4.0t

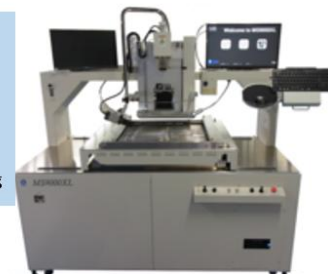
外観検査機(UV対応)
MEK
V22UVX-520



リペア機

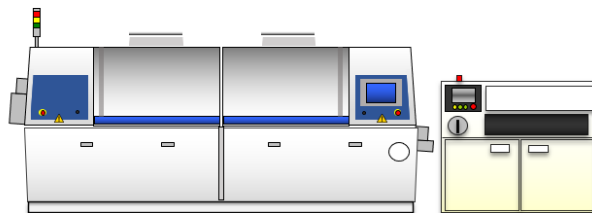
対応基板サイズ
Min 50×50～
Max 650×700
基板厚 10.0t
対応基板重量 10.0kg

メイショウ
MS9000XL



DIP装置 (鉛フリー) 千住金属工業 大気

対応基板サイズ
Min 50×50～
Max 460×610
対応基板厚 0.6～2.0t

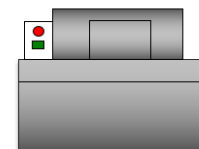


DIP槽
千住金属工業
SPF2-500

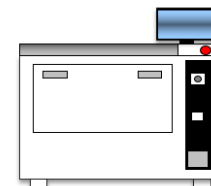
スプレーフラクサー
SSF2-400

ポイントDIP装置 セイテック N2

対応基板サイズ
Min 50×50～
Max 460×460



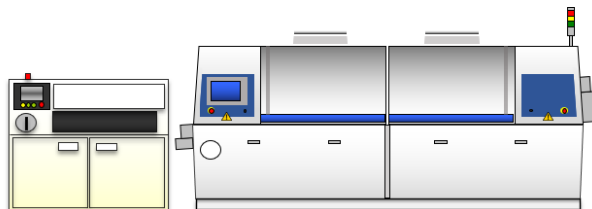
ポイントスプレー装置
セイテック
SPJ-500



セレクトィブトレース
(はんだ付け装置)
セイテック (N2対応)
STS-500Plus

DIP装置 (共晶) 千住金属工業 大気

対応基板サイズ
Min 50×100～
Max 330×450
対応基板厚 0.6～2.0t



スプレーフラクサー
TAF-40-15PV

DIP槽
千住金属工業
SPF2-400

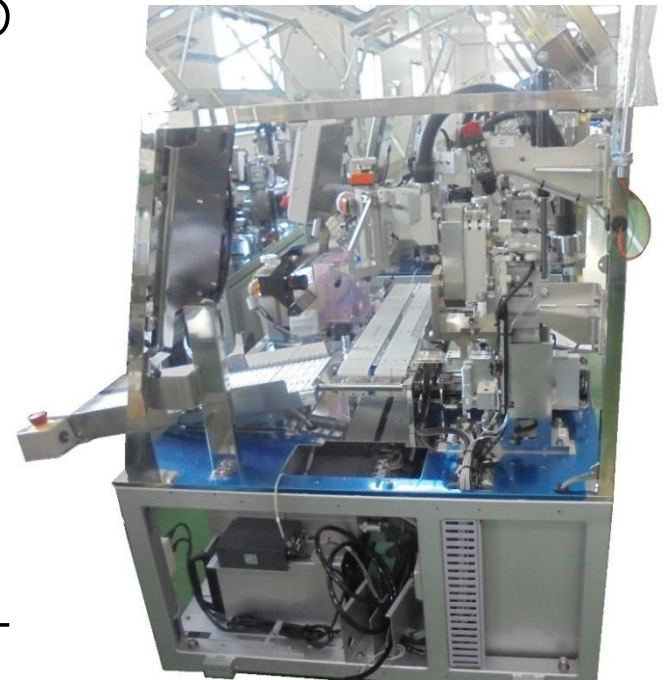
2. 装置組立事業(装置製造部)

受託範囲:ハーネス加工～制御ユニット及び本体組立・調整迄の一貫生産

主力アイテム:各種産業機器・検査装置・搬送装置等

装置組立：生産

- 各種ハーネス加工～制御ユニット組立迄の一貫生産で短納期対応が可能です
- メカユニットは、高精度の組立てを得意としております
- ハーネス・制御ユニット・メカユニット組立後装置本体搭載、最終調整・I Oチェックを経て出荷します
- 各種ユニットの単品組立から対応可能です



(株)熊本マランツ レイアウト図

作成日:2025年 1月10日「30版」



改版層	改版日	2011.9.1	作業フロア変更の為	(09版発行)	改版日	2014.7.1	作業フロア変更の為	(15版発行)	改版日	2017.8.23	作業フロア変更の為	(21版発行)	改版日	2021.1.12	作業フロア変更の為	(27版発行)
	改版日	2012.2.1	作業フロア変更の為	(10版発行)	改版日	2015.2.16	作業フロア変更の為	(16版発行)	改版日	2018.1.10	作業フロア変更の為	(22版発行)	改版日	2022.10.1	作業フロア変更の為	(28版発行)
	改版日	2012.4.1	作業フロア変更の為	(11版発行)	改版日	2015.4.24	作業フロア変更の為	(17版発行)	改版日	2019.1.17	作業フロア変更の為	(23版発行)	改版日	2024.01.4	作業フロア変更の為	(29版発行)
	改版日	2012.8.1	作業フロア変更の為	(12版発行)	改版日	2015.7.2	作業フロア変更の為	(18版発行)	改版日	2019.1.21	作業フロア変更の為	(24版発行)	改版日	2025.01.10	危険物倉庫を追加	(30版発行)
	改版日	2014.1.7	作業フロア変更の為	(13版発行)	改版日	2015.10.16	作業フロア変更の為	(19版発行)	改版日	2020.1.8	作業フロア変更の為	(25版発行)				
	改版日	2014.4.21	作業フロア変更の為	(14版発行)	改版日	2017.1.16	作業フロア変更及び第2駐車場売却	(20版発行)	改版日	2020.6.30	作業フロア変更の為	(26版発行)				